

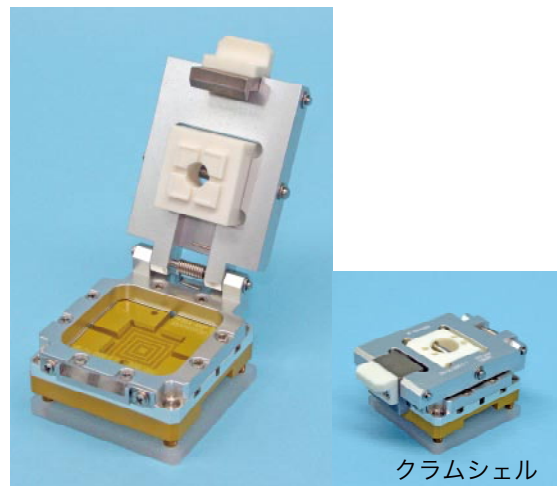
BGA / LGA / QFN 検査用テストソケット

BGA / LGA / QFN Test Socket

yokowo



マニュアルワンタッチ



クラムシェル

BGA / LGA / QFN 検査用テストソケット

用途

- ・ BGA / LGA / QFNパッケージICのファンクション検査
- ・ BGA / LGA / QFNパッケージICのバーイン検査

特長

- ・ 高性能、高耐久、高信頼性コンタクトプローブを採用
- ・ メンテナンス性を重視したプローブ交換方式を採用
- ・ 1.27mm～0.3mmピッチまで対応可能
- ・ 標準プローブを使用し、お客様仕様でのソケット形状が製作可能
- ・ 検査以外の仮実装用およびウエハレベルCSP検査への展開が可能

仕様

ソケットタイプ	オープントップ、クラムシェル、マニュアルワンタッチ
対応ピッチ	0.3mm～1.27mm
温度範囲	－55℃～＋125℃(＋150℃)※
構造	切削品 又は 成型品
材質	スーパーエンブラ

※ 150℃は特殊仕様となります